



№ з/п	Освітня компонента	Підсумковий контроль		курсове проектування	Обсяг освітньої компоненти у кредитах ЄКТС (1 кредит=30 годин)	Вид та обсяг навчальних занять							Логічна послідовність освітніх компонентів (кількість аудиторних годин по курсах і семестрах)												кафедра			
		екзамен	залік			Всього годин	Макс.обсяг аудиторних занять (годин)					мін.обсяг ЄРС (годин)	1 курс				2 курс											
							всього	лекції	практичні заняття	лабораторні роботи	Консультації		1		2		3											
		кількість тижнів у семестрі (вивчення дисциплін)												17				17				17						
		лк	пз			лб	конс	лк	пз	лб	конс	лк	пз	лб	конс													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
<b>ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ (ФАХОВОЇ) ПІДГОТОВКИ</b>																												
<b>Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (обов'язкові)</b>																												
1*	Українська мова як іноземна		2		3	90	36		30		6	54		30		6										МП		
<b>Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни (вибіркові)</b>																												
2	Ділова іноземна мова		2		3	90	36		30		6	54					30		6							Ін.мов		
3	Філософські проблеми наукового пізнання		2		3	90	36	18	12		6	54					18	12		6						Філ.		
4	Стилістика наукового тексту		2		3	90	36	18	12		6	54					18	12		6						Укр		
5	Педагогіка вищої школи		2		3	90	36	18	12		6	54					18	12		6						Філ.		
6	Економічне обґрунтування проєктів ВСЬОГО		2		3	90	36	18	12		6	54					18	12		6						ЕК		
7	Фізичне виховання (за рахунок вільного часу студентів)		1		3	90	36	18	12		6	54					18	12		6						Фізвих.		
<b>Дисципліни базової (професійної) підготовки за спеціальністю (обов'язкові)</b>																												
8	Наноелектронні системи		1		5	150	60	26	12	12	10	90	26	12	12	10										МЕЕПП		
9	Пристрої інтегральної опти-, фото- і акустоелектроніки	1		ІКР	6	180	72	30	18	12	12	108	30	18	12	12										МЕЕПП		
10	Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право	1			6	180	72	30	30	0	12	108	30	30	0	12										МЕЕПП		
11	Елементна база сучасної мікроелектроніки НВЧ	2			7	210	84	36	18	16	14	126					36	18	16	14						МЕЕПП		
12	Зондові технології наноелектроніки ВСЬОГО	1	4	1	5	150	60	26	12	12	10	90	26	12	12	10										МЕЕПП		
	РАЗОМ (цикл загальної та спеціальної (фахової) підготовки)	4	3		29	870	348	148	90	52	58	522	112	72	36	44	36	18	16	14	0	0	0	0		МЕЕПП		
		4	3		32	960	384	166	102	52	64	576	112	72	36	44	54	30	16	20	0	0	0	0				
<b>ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ</b>																												
<b>Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (обов'язкові)</b>																												
13	Електроніка телекомунікаційних систем		1		4	120	48	20	12	8	8	72	20	12	8	8										МЕЕПП		
14	Мікроелектромеханічні системи		1		4	120	48	20	8	12	8	72	20	8	12	8										МЕЕПП		
15	Органічні напівпровідникові матеріали		2		6	180	72	30	18	12	12	108					30	18	12	12						МЕЕПП		
16	Передатестайіна практика		3		12	360						360														МЕЕПП		
17	Кваліфікаційна робота		3		12	360						360														МЕЕПП		
	ВСЬОГО		4		38	1140	168	70	38	32	28	972	40	20	20	16	30	18	12	12	0	0	0	0				

Дисципліни професійної та практичної підготовки за освітньою програмою «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої» (вибіркові)																										
18	Інтегральні схеми запам'ятовуючих пристроїв		2		5	150	60	26	12	12	10	90					26	12	12	10					МЕЕПП	
19	Елементна база телекомунікацій		2		5	150	60	26	12	12	10	90					26	12	12	10					МЕЕПП	
20	Технологія нанорозмірних систем	2			5	150	60	26	12	12	10	90					26	12	12	10					МЕЕПП	
21	Електроніка терагерцового діапазону	2			5	150	60	26	12	12	10	90					26	12	12	10					МЕЕПП	
22	Вуглецеві нанотрубки	2			4	120	48	20	8	12	8	72					20	8	12	8					МЕЕПП	
23	Метаматеріали в електроніці	2			4	120	48	20	8	12	8	72					20	8	12	8					МЕЕПП	
24	Комп'ютерне моделювання наноструктур		3		6	180	72	30	14	16	12	108										30	14	16	12	МЕЕПП
25	Пакети прикладних програм		3		6	180	72	30	14	16	12	108										30	14	16	12	МЕЕПП
	ВСЬОГО	2	2		20	600	240	102	46	52	40	360	0	0	0	0	72	32	36	28	30	14	16	12		
	РАЗОМ (цикл професійної підготовки)	2	6		58	1740	408	172	84	84	68	1332	40	20	20	16	102	50	48	40	30	14	16	12		
	РАЗОМ (обов'язкові компоненти)				67	2010	516	218	128	84	86	1494	152	92	56	60	66	36	28	26	0	0	0	0		
	кредитів у семестрі																20		16							
	РАЗОМ (вибіркові компоненти)				23	690	276	120	58	52	46	414	0	0	0	0	90	44	36	34	30	14	16	12		
	кредитів у семестрі																0		14							
	ВСЬОГО ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА				90	2700	792	338	186	136	132	1908	152	92	56	60	156	80	64	60	30	14	16	12		
	кредитів у семестрі																20		30							
	ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН												360				360				72					
	КІЛЬКІСТЬ АУДИТОРНИХ ГОДИН НА ТИЖДЕНЬ												21,18				21,18				36,00					
													Кількість іспитів				3				3					
													Кількість заліків				4				3					
													Кількість курсових проєктів і робіт				1									

\* Для іноземних здобувачів вищої освіти

УЗГОДЖЕНО

Перший проректор

І.В.Рубан

Керівник проєктної групи  
за спеціальністю 153

І.М.Бондаренко

Керівник ОМЦ

І.В.Магдаліна

Декан факультету ЕЛБІ

А.В.Васянович

Начальник НВ

А.В.Міхнова

Зав.кафедри МЕЕПП

І.М.Бондаренко

Навчальний план розроблено на основі освітньо-професійної програми  
«Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої»  
за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка  
для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Узгоджено на Вченій раді факультету ЕЛБІ протокол від 25.01.21 № 1